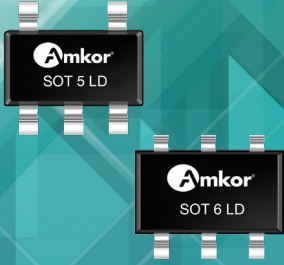


# SOT-23/TSOT



## FEATURES

- ▶ 저비용의 Cu 와이어 인터커넥트
- ▶ JEDEC 및 EIAJ 표준 패키지 규격
- ▶ 스트립 테스트 옵션을 포함한 턴키 테스트 서비스
- ▶ 친환경 재료 사용 – 무연, RoHS 준수

## PROCESS HIGHLIGHTS

- ▶ Au 도금 PCC 와이어가 표준, Au 및 Ag 와이어 대응
- ▶ 웨이퍼 백그라잉팅 지원
- ▶ 필름 다이 어태치 재료를 사용한 Chip-on-lead 지원 가능
- ▶ Matte Sn 리드 표준
- ▶ 패키지 레이저 마크

SOT-23 (Small Outline Transistor) 및 TSOT (Thin Small Outline Transistor)는 매우 작은 풋프린트를 요구하는 애플리케이션에 최적화된 리드프레임 패키지입니다. 이 제품은 표준 패키지로 폭넓게 양산되고 있으며, 다양한 애플리케이션에 비용 효율적인 솔루션을 제공할 수 있습니다. 최대 8개의 핀 리드를 가진 SOT-23/TSOT 패키지는 기존 SOIC 또는 TSSOP 패키지에 배치된 소형 IC를 처리할 수 있습니다.

## Reliability Qualification

앰코의 패키지 인증 시험에는 3개의 독립 제조 로트 및 테스트 그룹별 최소 77개의 유닛이 사용됩니다. 모든 테스트에는 JSTD-020 수분 전처리 과정이 포함됩니다.

- ▶ 습도 감지 특성(MSC): JEDEC level 3, 85°C/85% RH, 168 시간
- ▶ uHAST: 130°C/85% RH, no bias, 96 시간
- ▶ 온도 사이클: -65/+150°C, 500 사이클
- ▶ 고온방치(HTS): 150°C, 1000 시간

## Services and Support

앰코는 고객이 고품질 제품을 최저 비용으로 신속하게 출시할 수 있도록 광범위한 리소스 지원을 하고 있습니다.

- ▶ 전체 패키지 특성화 지원
- ▶ 열 특성, 기계적 스트레스 및 전기적 성능 모델링
- ▶ 턴키 어셈블리, 테스트 및 드롭십
- ▶ 세계 최고 수준의 신뢰성 테스트 및 불량 분석

## Test Services

- ▶ 프로그램 생성/변환
- ▶ 웨이퍼 프로브
- ▶ 번인 테스트(Burn-in capabilities)
- ▶ -55 ~ +165°C 테스트 지원
- ▶ 스트립 테스트 지원

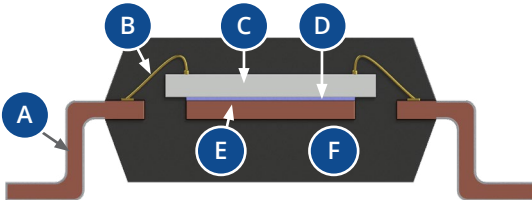
## Shipping Options

- ▶ 알루미늄 용기
- ▶ 테이프 및 릴
- ▶ 드라이 팩
- ▶ 드롭십(Drop Ship)

# SOT-23/TSOT

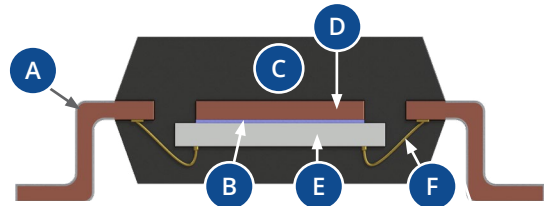
## Cross Sections

Die Up



- A** Cu leadframe
- B** Wirebond
- C** Die
- D** Die attach adhesive
- E** Reduced pad
- F** Mold compound

Die Down



- A** Cu leadframe
- B** Die attach adhesive
- C** Mold compound
- D** Reduced pad
- E** Die
- F** Wirebond

## Configuration Options

SOT-23/TSOT Nominal Package Dimensions (mm)

Package Type	Lead Count	Body Width	Body Length	Body Thickness	Overall Height	Lead Pitch	Tip-to-Tip	JEDEC/EIAJ
SOT-23	3	1.3	2.9	0.90	0.98	0.95/1.9	2.40	SOT346/ TO-236/SC-59
	4	1.3	2.9	0.90	0.98	1.92	2.40	SOT143/ TO-253
	5	1.6	2.9	1.15	1.23	0.95/1.9	2.80	MO-178
	6	1.6	2.9	1.15	1.23	0.95	2.80	MO-178
	8	1.6	2.9	1.15	1.23	0.65	2.80	MO-178
TSOT*	3	1.6	2.9	0.88	0.96	0.95/1.9	2.75	N/A
	5	1.6	2.9	0.88	0.96	0.95	2.75	MO-193
	6	1.6	2.9	0.88	0.96	0.95	2.75	MO-193
	8	1.6	2.9	0.88	0.96	0.65	2.75	MO-193

\*TSOT와 TSOP 명칭은 혼용될 수 있습니다



보다 자세한 내용은 홈페이지 [amkor.com](http://amkor.com)을 방문하시거나 [sales@amkor.com](mailto:sales@amkor.com)으로 문의하여 주시기 바랍니다.

본 문서의 모든 콘텐츠는 저작권법에 따라 무단복제 및 배포를 금지하며, 제공된 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 앰코는 본 문서의 정보사용에 따른 특허나 라이선스 등과 관련된 어떠한 형태의 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 앰코의 제품보증과 관련하여 표준판매약관에 명시된 것 이상으로 확대하거나 변경하지 않습니다. 앰코는 사전고지 없이 수시로 제품 및 제품정보를 변경할 수 있습니다. 앰코의 이름 및 로고는 Amkor Technology, Inc.의 등록상표입니다. 그 외 언급된 모든 상표는 각 해당 회사의 자산입니다.  
© 2021 Amkor Technology, Incorporated. All Rights Reserved. DS5810-KR Rev Date: 06/21

